

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 87v03.2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
TYTAN PROFESSIONAL TACK-R PIANOKLEJ DEKARSKI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL TACK-R PIANOKLEJ DEKARSKI
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL TACK-R PIANOKLEJ DEKARSKI jest przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych:
  - płyt z wełny mineralnej (MW) o TR  $\geq$  80 kPa wg PN-EN 13162;
  - płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) wg PN-EN 13163;
  - gładkich płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) wg PN-EN 13164;
  - gładkich płyt poliizocyanurowych (PIR) wg PN-EN 13165;
  - płyt poliizocyanurowych (PIR) z welonem aluminiowym wg PN-EN 13165;
  - gładkich płyt poliuretanowych (PUR) wg PN-EN 13165;do podłoży mineralnych, np. betonowych, ceramicznych przy wykonywaniu zewnętrznych systemów izolacji cieplnej ETICS, w tym przy wykonywaniu drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych oraz przy wykonywaniu ociepleń dachów płaskich.  
Wszystkie płyty mogą być mocowane do podłoży pokrytych papą, drewnianych i z płyt OSB oraz blaszanych ocynkowanych.  
Dodatkowo płyty z EPS i XPS mogą być mocowane do mineralnych warstw zbrojących, tynków mineralnych, silikonowych i akrylowych.  
Klej poliuretanowy TYTAN PROFESSIONAL TACK-R PIANOKLEJ DEKARSKI jest również przeznaczony do mocowania płyt EPS i XPS do podłoży z hydroizolacją bitumiczną (w podziemnych częściach budynków).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Selena S.A., ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 3
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT-2020/0109 wydanie 2  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr akredytacji AC 008,  
 nr certyfikatu 008-UWB-164

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Stopień ekspansji (przyrost wysokości), mm	≤ 3,0	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 140	
Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa	≥ 400	
<b>Płyty z wełny mineralnej (MW)</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta MW – spoina klejowa 8 mm –beton, MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	
- temperaturze -5°C	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	
- temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni w temperaturze 0°C połączenia: płyta MW – spoina klejowa 8 mm - podłoże (papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie	
<b>Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS)</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta EPS – spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 0°C	≥ 0,08	
- temperaturze 35°C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta EPS – spoina klejowa 8 mm – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08	
- temperaturze -5°C	≥ 0,08	
- temperaturze -5°C przy zmienionej grubości spoiny do 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30%	≥ 0,08	

<b>Gładkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna XPS- spoina klejowa 8 mm -podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana, hydroizolacja bitumiczna), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0°C	≥ 0,08	
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min. przy zmienionej grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 35°C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna XPS- spoina klejowa 8 mm -podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08	
- temperaturze -5°C	≥ 0,08	
- temperaturze -5°C przy grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30%	≥ 0,08	
<b>Gładkie płyty poliizocyanurowe PIR</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR - spoina klejowa 8 mm -podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- warunkach laboratoryjnych przy grubości przy grubości spoiny 15 mm	≥ 0,08	
- temperaturze 0°C	≥ 0,08	
- temperaturze 35°C i wilgotności względnej 30%	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR – w temperaturze 0°C i przy spoinie klejowej 15 mm – podłoże (beton, drewno, blacha ocynkowana), MPa, po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR – spoina klejowa – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk silikonowy, tynk akrylowy) w temperaturze -5°C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
-spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	
<b>Płyty poliizocyanurowe PIR z welonem aluminiowym</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR z welonem aluminiowym - spoina klejowa 8 mm -podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowana), MPa, w:		

- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 3 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0°C	≥ 0,08	
-temperaturze 30°C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PIR z welonem aluminiowym - spoina klejowa – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca tynk mineralny, tynk silikonowy) w temperaturze -5°C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
-spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	
<b>Gładkie płyty poliuretanowe (PUR)</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR - spoina klejowa 8 mm – podłoże (beton, papa, drewno, płyta OSB, blacha ocynkowa), MPa, w:		
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
- temperaturze 0°C	≥ 0,08	
-temperaturze 35°C i wilgotności względnej 30 %	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR – w temperaturze 0°C i przy spoinie klejowej 15 m – podłoże (beton, papa), MPa, po czasie otwartym 1 min.	≥ 0,08	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni połączenia płyta termoizolacyjna PUR – spoina klejowa – podłoże (mineralna warstwa zbrojąca, tynk mineralny, tynk akrylowy, tynk silikonowy) w temperaturze - 5°C, MPa		
- spoina klejowa 8 mm	≥ 0,08	
-spoina klejowa 15 mm	≥ 0,08	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(a):

Dorota Godzisz, R&D Certification Manager

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 28-11-2023

.....  
(miejsce i data wydania)

*D. Godzisz*  
.....  
(podpis)